

## 评级：增持（维持）

分析师：王芳

执业证书编号：S0740521120002

Email: wangfang02@zts.com.cn

分析师：杨旭

执业证书编号：S0740521120001

Email: yangxu01@zts.com.cn

分析师：李雪峰

执业证书编号：S0740522080004

Email: lixf05@zts.com.cn

分析师：游凡

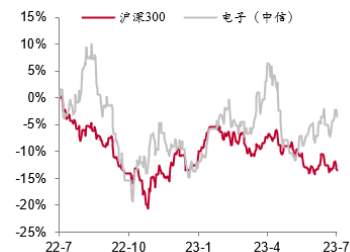
执业证书编号：S0740522120002

Email: youfan@zts.com.cn

## 基本状况

上市公司数	314
行业总市值(百万元)	4,637,468
行业流通市值(百万元)	2,430,006

## 行业-市场走势对比



## 相关报告

【中泰电子】半导体周跟踪：中芯国际 Q2 指引向好，看好行业复苏和国产替代主线

【中泰电子】半导体周跟踪：季报密集发布期，关注重点公司业绩

【中泰电子】半导体周跟踪：多款 AI 模型发布，半导体板块止跌反弹

## 重点公司基本状况

简称	股价 (元)	EPS				PE				PEG	评级
		2021	2022	2023E	2024E	2021	2022	2023E	2024E		
韦尔股份	105	3.8	0.8	1.8	2.9	28	130	58	36	0.5	买入
兆易创新	105	3.5	3.1	1.6	2.8	30	34	64	37	-1.4	买入
圣邦股份	82	1.5	1.8	1.3	2.0	55	44	63	40	-2.2	买入
士兰微	31	1.1	0.7	1.1	1.4	29	42	28	22	0.6	买入
复旦微电	56	0.6	1.4	1.8	2.4	89	41	31	24	0.9	买入
江丰电子	68	0.4	0.9	1.6	2.4	169	76	43	29	0.6	买入
北方华创	285	2.0	4.8	4.6	6.1	140	59	62	47	-16.5	买入
兴森科技	15	0.4	0.3	0.3	0.5	40	51	50	28	49.8	买入

备注：股价取自 2023 年 7 月 7 日收盘价

## 投资要点

### ■ 市场整体下跌，半导体指数下跌 2.17%

当周（2023/7/3-2023/7/7）市场整体下跌，沪深 300 指数跌 0.44%，上证综指跌 0.01%，深证成指跌 1.25%，创业板指数跌 2.07%，中信电子涨 0.85%，半导体指数跌 2.17%。其中：半导体设计涨 3.6%（聚辰股份涨 20.07%，晶丰明源涨 14.68%），半导体制造跌 2.2%（中芯国际 A 股跌 2.3%，中芯国际 H 股跌 3.4%），半导体封测跌 0.9%（长电科技跌 1.4%），半导体材料跌 3.2%（华懋科技涨 5.20%，TCL 中环跌 8.70%），半导体设备跌 8.4%（拓荆科技跌 18.6%，北方华创跌 10.2%），功率半导体涨 2.64%（宏微科技涨 9.3%，扬杰科技涨 5.7%）。

1) 目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代将加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及 Chiplet 等投资机遇。

2) 近日，2023 世界人工智能大会在上海召开，各项数据创历史新高，并推动了多个重大 AI 产业项目签约。此前海内外多款 AI 模型发布，算力是 AI 的底层核心，海外大厂持续发力 AI 芯片，算力芯片快速发展期到来，持续看好算力+应用两大赛道。

### ■ 行业新闻

#### 1) 2023 世界人工智能大会（WAIC）在上海召开，各项数据创历史新高

2023 世界人工智能大会于 7 月 6 日至 8 日在上海召开，截至 7 月 8 日下午 3:00，线下参观人数突破 17.7 万人，全网流量突破 10.7 亿人次，比上届增长了 68%。全网曝光量 64.1 亿，均创历史新高。此外，此次大会共对接 210 家上下游企业，达成 110 亿意向的采购金额，推动 32 个重大产业项目签约，项目投资总额 288 亿。

#### 2) 三大存储厂将上调 DRAM 合约价格，行业迎来拐点

据供应链人士消息，面对行业传统旺季，三大存储芯片原厂（三星、SK 海力士和美光）计划在 23Q3 提高 DRAM 合约价格，目标涨幅为 7%至 8%。市场分析机构 TrendForce 最近的报告指出，在 DRAM 现货市场上，近期低价 DDR4 产品出现了零星的涨价，而由于芯片供应充足，DDR5 产品的价格持续下降。该机构的另一份报告显示，DRAM 市场中的买家和供应商已开始讨论第三季度合同，初步报价显示，DDR5 和 LPDDR5X 产品的价格可能已经没有进一步下跌的空间。存储行业的这些迹象表明，该行业或将迎来拐点。

### 3) AI 服务器需求激增, HBM 内存价格上涨

集微网消息, 随着人工智能 (AI) 服务器需求的激增, 高带宽内存 (HBM) 的价格开始上涨。据台媒电子时报报道, 全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产 HBM。但由于调整产能需要时间, 很难迅速增加 HBM 的产量, 预计未来两年 HBM 供应仍将紧张。目前 HBM 市场仍由全球前三大 DRAM 芯片制造商主导, 其中 SK 海力士的市场份额高达 50%。

#### ■ 重要公告

**永新光学:** 7 月 4 日, 公司发布 2023 年股权激励计划 (草案), 拟授予核心管理及技术骨干成员限制性股票 72.8 万股 (约占总股本 0.66%), 首次授予 61.8 万股, 预留 11.0 万股, 授予价格 42.48 元/股。并设定业绩考核目标: 2023-25 年营收分别不低于 8.4/10.5/14.0 亿元 (同比 +1.3%/25.0%/33.3%) 或净利润 (剔除股份支付费用后的归母净利润) 不低于 3.0/3.5/4.1 亿元 (同比 +7.5%/16.7%/17.1%), 且 2023-25 年医疗光学业务营收不低于 0.61/0.90/1.40 亿元。

**兆易创新:** 7 月 5 日, 公司发布 2023 股票期权激励计划 (草案), 1) 拟向激励对象 1018 人授予 1081 万股股票期权, 约占总股本 1.62%, 行权价格为每股 86.47 元, 股票期权为一次性授予, 无预留权益。2) 业绩考核目标: 以 2018-2020 年收入均值为基数, 23/24/25/26 年收入增长率不低于 110%/120%/160%/180%, 对应 23/24/25/26 年收入目标为 70/73/86/93 亿元, 对应同比增速为 -14%/+5%/+18%/+8%, 23-26 年收入 CAGR +10%。

**华懋科技:** 7 月 6 日公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 (注册稿)》, 本次可转债募集资金总额为人民币 10.5 亿元, 其中 4.88 亿元用于越南生产基地建设项目 (一期), 3.56 亿元用于厦门生产基地改建扩建计划, 其余资金用于信息化建设项目以及研发中芯建设项目。项目建设期为三年, 达产后越南生产基地预计年产安全气囊袋 1,050 万个、OPW 气囊袋 214.5 万个, 厦门基地预计年产 OPW 气囊袋 429 万个, 安全气囊布 530 万米。

#### ■ 投资建议:

建议关注 AI 以算力为基础的芯片供应链机遇:

- (1) AI 应用: 大华股份、海康威视;
- (2) 服务器产业链: 寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康;
- (3) C 端 AI 应用: 瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者;
- (4) Chiplet: 通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。

国产化产业链机会:

- (1) 设备: 中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子;
- (2) 零部件: 福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材;
- (3) 材料: 沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。

静待周期复苏:

存储: 兆易创新、北京君正、东芯股份、深科技、普冉股份;

模拟: 圣邦股份、纳芯微、思瑞浦。

■ 风险提示: 需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。

## 内容目录

一、行情回顾：市场整体下跌，半导体指数跌 2.17%.....	- 4 -
二、行业新闻：三大存储厂将上调 DRAM 合约价格，HBM 需求激增.....	- 7 -
三、板块跟踪：关注景气度复苏弹性与国产替代机遇.....	- 9 -
四、重要公告：兆易创新、永新光学发布股权激励计划草案.....	- 10 -
五、投资建议.....	- 11 -
六、风险提示.....	- 13 -

## 一、行情回顾：市场整体下跌，半导体指数跌 2.17%

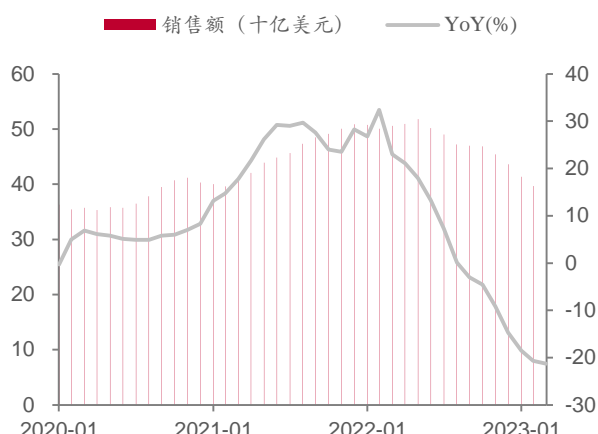
- 当周（2023/7/3-2023/7/7）市场整体下跌，沪深 300 指数跌 0.44%，上证综指跌 0.01%，深证成指跌 1.25%，创业板指数跌 2.07%，中信电子涨 0.85%，半导体指数跌 2.17%。其中：半导体设计涨 3.6%，半导体制造跌 2.2%，半导体封测跌 0.9%，半导体材料跌 3.2%，半导体设备跌 8.4%，功率半导体涨 2.64%。
- 当周（2023/7/3-2023/7/7）费城半导体指数下跌，跌幅为 2.60%，2023/01/01-2023/7/7 涨幅为 41.29%。台湾半导体指数周下跌 1.56%，2023/01/01-2023/7/7 涨幅为 25.11%。

图表 1：费城半导体指数



来源：wind，中泰证券研究所

图表 2：全球半导体月度销售额及增速



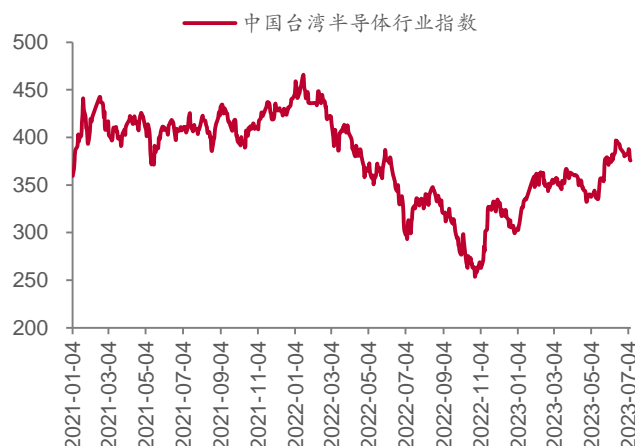
来源：wind，中泰证券研究所

图表 3：A 股半导体指数



来源：wind，中泰证券研究所

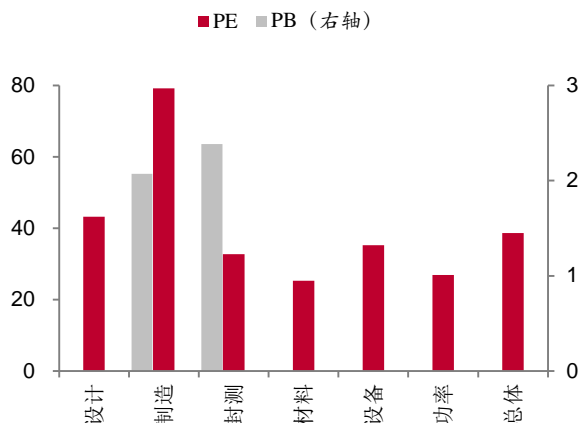
图表 4：中国台湾半导体指数



来源：wind，中泰证券研究所

图表 5：细分板块估值情况（2023）

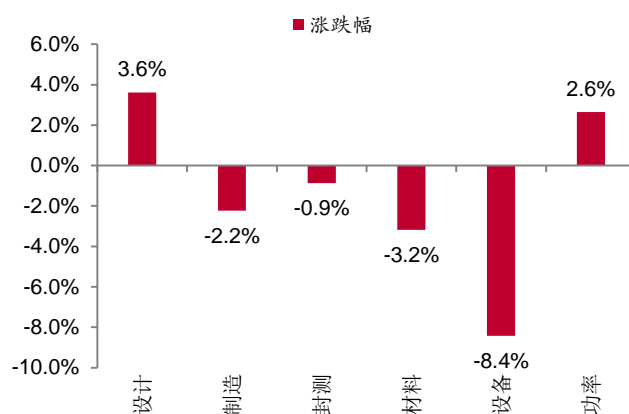
图表 6：当周半导体各细分板块涨跌幅情况



来源: wind, 中泰证券研究所

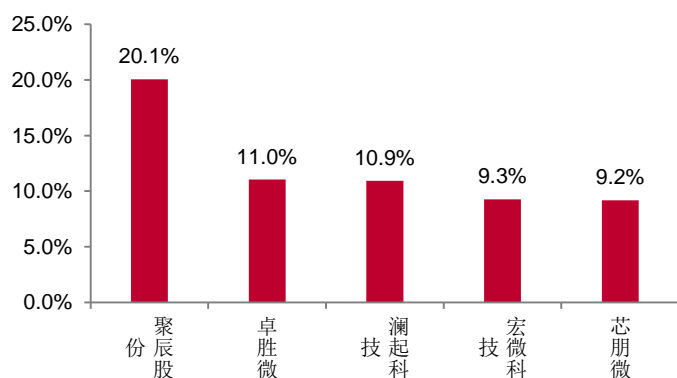
注: PE=最近市值/2023 年 wind 一致预期净利润

注: PB=最近市值/2023 年 wind 一致预期净资产



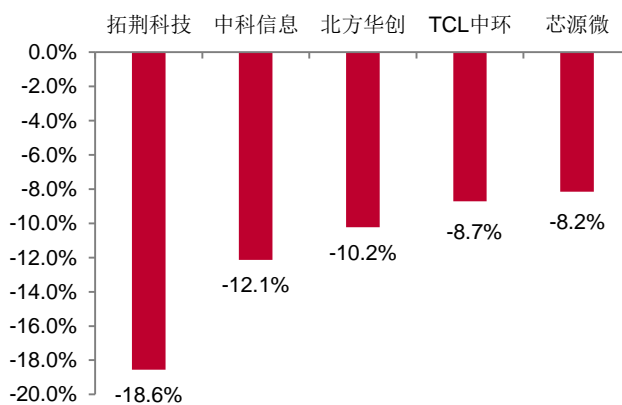
来源: wind, 中泰证券研究所

图表 7: 上周半导体行业涨跌幅前五公司



来源: wind, 中泰证券研究所

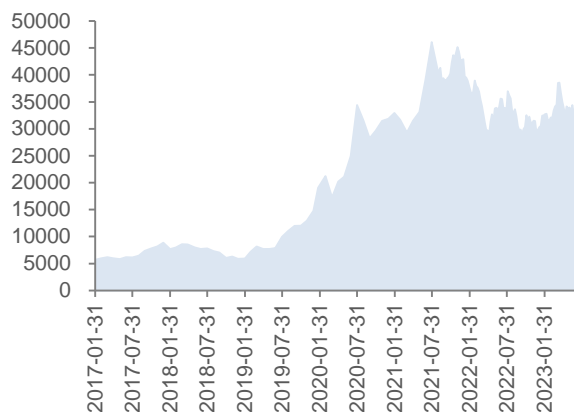
图表 8: 上周半导体行业涨跌幅后五公司



来源: wind, 中泰证券研究所

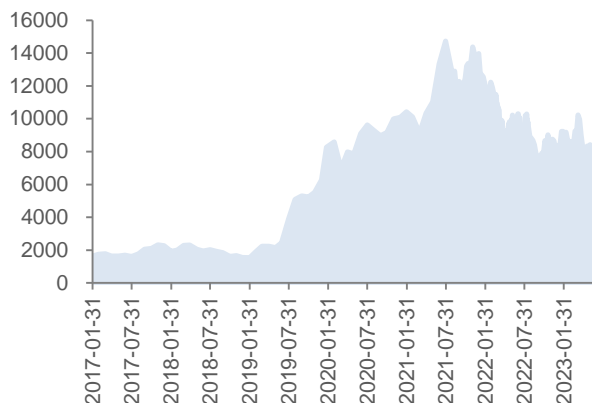
- 截至 7 月 7 日, A 股半导体公司总市值达 32511.5 亿元, 环比跌 1.30%。其中: 设计板块公司总市值 8137 亿元, 环比涨 3.25%; 制造板块公司总市值 6328 亿元, 环比跌 2.4%; 设备板块公司总市值 6201 亿元, 环比跌 7.08%; 材料板块公司总市值 4230 亿元, 环比跌 3.43%; 封测公司总市值 1884 亿元, 环比跌 2.78%; 功率板块总市值 6045 亿元, 环比涨 1.80%。

**图表 9: A 股半导体板块公司总市值 (亿元)**



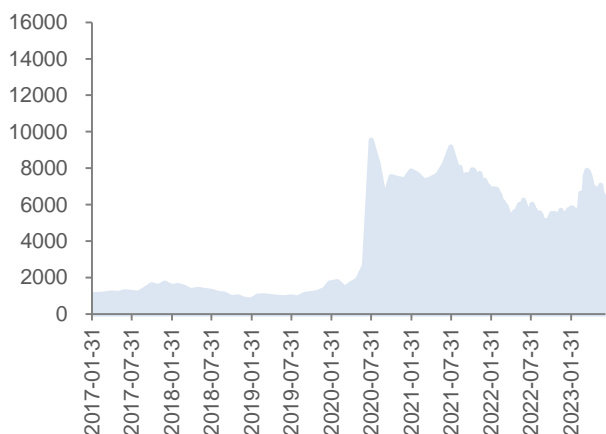
来源: wind, 中泰证券研究所

**图表 10: A 股半导体设计板块公司总市值 (亿元)**



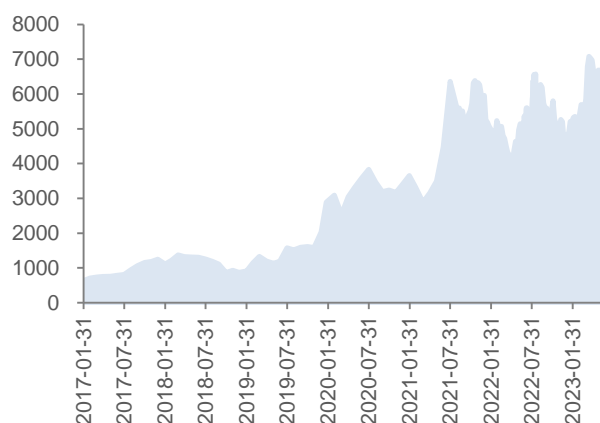
来源: wind, 中泰证券研究所

**图表 11: A 股半导体制造板块公司总市值 (亿元)**



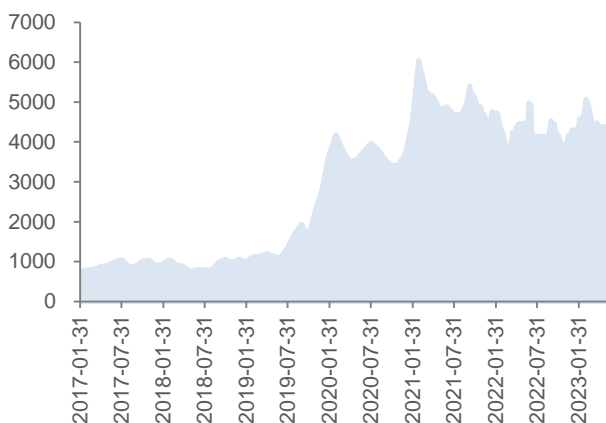
来源: wind, 中泰证券研究所

**图表 12: A 股半导体设备板块公司总市值 (亿元)**



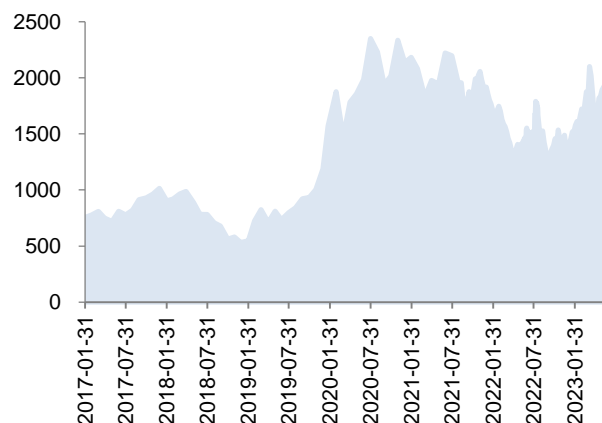
来源: wind, 中泰证券研究所

**图表 13: A 股半导体材料板块公司总市值 (亿元)**



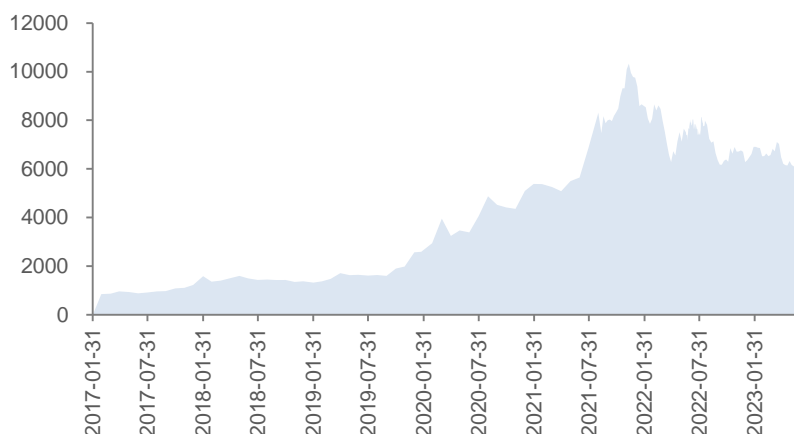
来源: wind, 中泰证券研究所

**图表 14: A 股半导体封测板块公司总市值 (亿元)**



来源: wind, 中泰证券研究所

图表 15: A 股功率板块公司总市值 (亿元)



来源: wind, 中泰证券研究所

- 当周 (2023/7/3-2023/7/7) 沪/深股通总体减持半导体板块。本周沪/深股通持股市值前 20 的企业中, 8 家企业获增持, 12 家企业被减持。增持金额前三公司为韦尔股份 (1.33 亿元)、中微公司 (1.01 亿元)、圣邦股份 (0.60 亿元), 减持金额前三公司为北方华创 (-4.42 亿元)、紫光国微 (-3.92 亿元)、通富微电 (-3.78 亿元)。

图表 16: 沪/深股通半导体板块持仓情况 (按持股市值排名)

本周排名	上周排名	证券代码	证券简称	一周增减持金额 (百万元)	一月增减持金额 (百万元)	年初至今增减持金额 (百万元)	沪(深)股通持股市值 (百万元)	沪(深)股通持股占自由流通股比例 %
1	1	603501.SH	韦尔股份	133	220	2,426	12,265	16
2	2	300316.SZ	晶盛机电	28	335	3,469	9,631	24
3	3	002371.SZ	北方华创	-442	384	570	6,458	8
4	4	002129.SZ	TCL中环	-147	-178	384	6,246	7
5	5	688012.SH	中微公司	101	1,194	877	4,660	7
6	6	688008.SH	澜起科技	-73	348	1,784	4,222	8
7	7	603986.SH	兆易创新	-133	-197	239	2,985	5
8	9	603290.SH	斯达半导	39	-567	-1,286	2,774	15
9	10	300782.SZ	卓胜微	-41	-215	711	2,634	8
10	8	002008.SZ	大族激光	-85	-104	-1,154	2,556	12
11	12	600584.SH	长电科技	5	64	540	1,889	5
12	11	002049.SZ	紫光国微	-392	-461	-1,247	1,781	3
13	13	300661.SZ	圣邦股份	60	-67	-780	1,717	7
14	14	002180.SZ	纳思达	-298	-348	593	1,460	5
15	15	600745.SH	闻泰科技	-50	-130	-222	1,452	4
16	16	300054.SZ	鼎龙股份	56	103	302	1,332	8
17	17	002156.SZ	通富微电	-378	-481	527	978	4
18	19	688396.SH	华润微	-13	17	135	917	4
19	18	688200.SH	华峰测控	9	-60	37	896	8
20	20	600460.SH	士兰微	-10	-19	-149	855	3

来源: wind, 中泰证券研究所

注: 此表中沪(深)股通持股市值=沪(深)股通持股数量\*上周交易均价, 数据更新截止于 2023/7/7;

## 二、行业新闻: 三大存储厂将上调 DRAM 合约价格, HBM 需求激增

- 2023 世界人工智能大会 (WAIC) 在上海召开, 各项数据创历史新高



2023 世界人工智能大会于 7 月 6 日至 8 日在上海召开，截至 7 月 8 日下午 3:00，线下参观人数突破 17.7 万人，全网流量突破 10.7 亿人次，比上届增长了 68%。全网曝光量 64.1 亿，均创历史新高。此外，此次大会共对接 210 家上下游企业，达成 110 亿意向的采购金额，推动 32 个重大产业项目签约，项目投资总额 288 亿。

求将企稳回升，传统 LED 市场也将重新回归良好的趋势。公司碳化硅各环节业务顺利推进，截至目前，已签署的碳化硅 MOSFET 长期采购协议总金额超 70 亿元，另有几家新能源汽车客户的合作意向在跟进。公司将持续提升 LED 业务高端产品占比和加速集成电路业务拓展，争取新的一年实现整体销售规模迈上更高台阶，利润有质量的增长，推动公司稳步持续健康发展。

链接：

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1770859604248936866&wfr=spider&for=pc>

### ■ 瑞萨电子与 Wolfspeed 签署 10 年碳化硅晶圆供应协议

7 月 5 日，日本车用芯片厂商瑞萨电子与美国半导体制造商 Wolfspeed 宣布，已签署为期 10 年的碳化硅晶圆供应协议。根据协议，Wolfspeed 要从 2025 年起向瑞萨电子提供 150mm 碳化硅裸片和外延晶圆，且在公司位于美国北卡罗来纳州的 John Palmour 碳化硅制造中心全面运营之后，还将向瑞萨电子供应 200mm 碳化硅裸晶圆和外延片。瑞萨电子则需向 Wolfspeed 支付 20 亿美元定金，用于确保碳化硅裸片和外延晶圆的供应，并支持 Wolfspeed 在美国的产能扩张计划。

链接：<http://www.cena.com.cn/semi/20230706/120728.html>

### ■ 三大存储厂将上调 DRAM 合约价格，行业迎来拐点

据供应链人士消息，面对行业传统旺季，三大存储芯片原厂（三星、SK 海力士和美光）计划在下一季度提高 DRAM 合约价格，目标涨幅为 7%至 8%。市场分析机构 TrendForce 最近的报告指出，在 DRAM 现货市场上，近期低价 DDR4 产品出现了零星的涨价，而由于芯片供应充足，DDR5 产品的价格持续下降。该机构的另一份报告显示，DRAM 市场中的买家和供应商已开始讨论第三季度合同，初步报价显示，DDR5 和 LPDDR5X 产品的价格可能已经没有进一步下跌的空间。存储行业的这些迹象表明，该行业或将迎来拐点。

链接：

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1770683749878486968&wfr=spider&for=pc>

### ■ AI 服务器需求激增，HBM 内存价格上涨

集微网消息，随着人工智能（AI）服务器需求的激增，高带宽内存（HBM）的价格开始上涨。据台媒电子时报报道，全球前三大存储芯片制造商目前正将更多产能转移至生产 HBM。但由于调整产能需要时间，很难迅速增加 HBM 的产量，预计未来两年 HBM 供应仍将紧张。目前 HBM 市场仍由全球前三大 DRAM 芯片制造商主导，其中 SK 海力士的市场份额高达 50%。消息人士表示，虽然韩国的竞争对手在 HBM 市场上起步较早，但美光科技也在向客户发送 HBM 产品的样品，计划从 2024 年初开始批量生产。

链接：



[https://view.inews.qq.com/k/20230706A039GY00?no-redirect=1&web\\_channel=wap&openApp=false](https://view.inews.qq.com/k/20230706A039GY00?no-redirect=1&web_channel=wap&openApp=false)

#### ■ 力积电与 SBI 达成协议，拟于日本建设 12 英寸晶圆代工厂

据力积电官网消息，力积电与日本 SBI 控股株式会社于 7 月 5 日达成协议，拟合作在日本境内建设 12 英寸晶圆代工厂。双方未来将在此协议框架下，共同设立筹备公司，并通过该公司陆续展开 12 英寸晶圆厂相关的规划及建厂作业。黄崇仁表示，力积电是唯一具备存储与逻辑技术能力的专业晶圆代工公司，将以自行开发的 22/28 纳米以上制程及晶圆堆叠（Wafer on Wafer）技术，以满足未来 AI 边缘计算所产生的多重应用，同时补强本土车用芯片的缺口。

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/t3K72U77ePNF8YVsgMEDbg>

#### ■ 三安光电：已签署碳化硅 MOSFET 长期采购协议总金额超 70 亿元

7 月 5 日，三安光电在互动平台称随着经济复苏、相关政策的逐步落地，需求将企稳回升，传统 LED 市场也将重新回归良好的趋势。公司碳化硅各环节业务顺利推进，截至目前，已签署的碳化硅 MOSFET 长期采购协议总金额超 70 亿元，另有几家新能源汽车客户的合作意向在跟进。公司将持续提升 LED 业务高端产品占比和加速集成电路业务拓展，争取新的一年实现整体销售规模迈上更高台阶，利润有质量的增长，推动公司稳步持续健康发展。

链接：[https://mp.weixin.qq.com/s/uQs3NrArvuHyrnL\\_6xf5xAl](https://mp.weixin.qq.com/s/uQs3NrArvuHyrnL_6xf5xAl)

#### ■ 瀚天天成正式宣布开始量产 8 英寸碳化硅外延晶片

瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司在第五届深圳国际半导体技术暨应用展览会上宣布，研发团队完成了具有自主知识产权的 8 英寸碳化硅外延工艺的技术开发，瀚天天成正式具备了国产 8 英寸碳化硅外延晶片量产能力。瀚天天成上周完成了多项长期合约（LTA）的签订，包括价值超过 1.92 亿美元的 8 英寸长约。公司所生产的 8 英寸碳化硅外延晶片的质量达到国际先进水平，即厚度不均匀性小于 3%，浓度不均匀性小于 6%，2mm\*2mm 管芯良率达到 98% 以上。该技术突破标志着我国已经掌握商业化的 8 英寸碳化硅外延生长技术，进一步推进了碳化硅外延材料的国产化进程，极大地提升了我国在碳化硅外延领域的国际地位。

链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/z7VLFj-kdsTobQOEZP5pQ>

### 三、板块跟踪：关注景气度复苏弹性与国产替代机遇

- **模拟**：当周模拟芯片设计（申万三级）板块+1.39%。模拟芯片板块前期回调，主要系受周期下行叠加高研发投入影响，主要公司短期业绩承压，以及市场担忧复苏持续性。目前行业至暗时刻已过，主要标的 Q2 边际向好，模拟 IC 具备长周期成长属性，重视低位反转&高成长模拟赛道标的，关注主要标的库存、下游景气度变化，复苏进度或出现分化。
- **MCU**：本周板块震荡，涨跌幅在-1%~+7%不等。
- **存储**：本周板块震荡，涨跌幅-6%~+32%。存储股价&估值&盈利大弹性，复苏量价齐升逻辑最佳，拐点已至，持续看好大弹性与强周期。

- **功率半导体：**本周 IGBT 指数上涨 1.5%。宏微科技上涨 9.3%，扬杰科技上涨 5.7%，斯达半导上涨 5.0%，捷捷微电上涨 2.3%。本周功率板块在汽车产业链的带动下上涨。
- **半导体设备：**Wind 半导体设备指数本周下降 4.8%，拓荆科技下降 18.6%，北方华创下降 10.2%，芯源微下降 8.2%，中科飞测下降 7.2%，华海清科下降 6.5%。本周拓荆科技跌幅较大，带动设备板块下跌。中长期来看，随着荷兰出口管制落地，日本对华出口限制即将生效，设备国产化作为国家战略方向，国产替代进程正加速推进，我们持续看好设备板块。
- **半导体制造：**本周中芯国际 A 股下降 2.3%、中芯国际 H 股下降 3.4%，华虹半导体上涨 1.4%。中芯国际及华虹目前处于景气底部，市场预期 H2 景气度上行。当前国家高度重视半导体产业，需重视制造龙头在国家半导体战略中的重要地位，同时我们也看好景气复苏后对制造公司产能利用率和盈利的改善，未来中芯国际、华虹半导体的扩产有望支撑其在国内份额的提升。
- **封测：**本周长电科技下降 1.4%，通富微电下降 0.7%，晶方科技下降 0.2%，华天科技上涨 0.9%。封测板块本周波动较小，中长期来看，景气复苏预期+chiplet 渗透率提升双重催化，我们看好封测板块。
- **光刻胶：**光刻胶板块本周出现分化，其中华懋科技涨 5.20%，雅克科技涨 0.58%，晶瑞电材涨 0.25%，上海新阳跌 2.98%，南大光电跌 3.29%，彤程新材跌 4.85%。目前中高端 KrF、ArF 国产化率极低，作为壁垒最高的半导体材料之一，光刻胶的自主化已成为国家战略，下游晶圆厂验证意愿持续加强，给国产光刻胶的切换与导入带来历史性机遇。此外，随着中美摩擦进一步演化，美国、日本对国内先进制程的封锁或将进一步延伸到半导体关键材料，光刻胶国产替代有望提速。
- **硅片：**本周半导体材料硅片板块反弹，其中沪硅产业上涨 2.63%，中晶科技上涨 2.06%，神工股份上涨 2.06%，立昂微上涨 0.44%，TCL 中环下跌 8.70%。

#### 四、重要公告：兆易创新、永新光学发布股权激励计划草案

- **赛微微：**6 月 30 日公告，公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；拟回购价格：不超过人民币 45 元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元(含)且不超过人民币 5,000 万元(含)。
- **兆易创新：**7 月 5 日，公司发布 2023 股票期权激励计划（草案），1）拟向激励对象 1018 人授予 1081 万股股票期权，约占总股本 1.62%，行权价格为每股 86.47 元，股票期权为一次性授予，无预留权益。2）业绩考核目标：以 2018-2020 年收入均值为基数，23/24/25/26 年收入增长率不低于 110%/120%/160%/180%，对应 23/24/25/26 年收入目标为 70/73/86/93 亿元，对应同比增速为-14%/+5%/+18%/+8%，23-26 年收入 CAGR +10%。
- **永新光学：**7 月 4 日，公司发布 2023 年股权激励计划（草案），拟授

予核心管理及技术骨干成员限制性股票 72.8 万股(约占总股本 0.66%),首次授予 61.8 万股,预留 11.0 万股,授予价格 42.48 元/股。并设定业绩考核目标: 2023-25 年营收分别不低于 8.4/10.5/14.0 亿元(同比+1.3%/25.0%/33.3%)或净利润(剔除股份支付费用后的归母净利润)不低于 3.0/3.5/4.1 亿元(同比+7.5%/16.7%/17.1%),且 2023-25 年医疗光学业务营收不低于 0.61/0.90/1.40 亿元。

- **华懋科技:** 公司 7 月 6 日发布《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》,本次可转债募集资金总额为人民币 10.5 亿元,其中 4.88 亿元用于越南生产基地建设项目(一期),3.56 亿元用于厦门生产基地改建扩建计划,其余资金用于信息化建设项目以及研发中芯建设项目。项目建设期为三年,达产后越南生产基地预计年产安全气囊袋 1,050.00 万个、OPW 气囊袋 214.50 万个,厦门基地预计年产 OPW 气囊袋 429 万个,安全气囊布 530 万米。
- **南大光电:** 7 月 6 日公司发布公告,拟通过发行股份及支付现金方式购买南晟壹号持有的全椒南大 16.5398%股权,具体股份和现金支付比例将根据标的资产的最终交易价格由各方协商,并在重组报告书中予以披露。本次交易完成后,上市公司将直接持有全椒南大 100.00%股权。
- **华海清科:** 7 月 7 日发布公告,华海清科股份有限公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的首次授予条件已经成就,根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,公司审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意以 2023 年 7 月 6 日为首次授予日,以 97.40 元/股的授予价格向 257 名激励对象授予 187.8136 万股限制性股票。
- **三安光电:** 7 月 7 日发布关于 2019 年度非公开发行限售股上市流通的公告。本次限售股上市流通数量为 400,916,380 股,占公司当前股份总数的 8.04%,本次限售股上市流通日期为 2023 年 7 月 13 日。

## 五、投资建议

### ■ 建议关注 AI 以算力为基础的芯片供应链机遇:

- (1) AI 应用: 大华股份、海康威视;
- (2) 服务器产业链: 寒武纪、工业富联、沪电股份、奥士康;
- (3) C 端 AI 应用: 瑞芯微、晶晨股份、中科蓝讯、国光电器、漫步者;
- (4) Chiplet: 通富微电、长电科技、华海清科、长川科技、兴森科技。

### ■ 国产化产业链机会:

- (1) 设备: 中微公司、拓荆科技、芯源微、北方华创、精测电子;
- (2) 零部件: 福晶科技、茂莱光学、江丰电子、正帆科技、富创精密、新莱应材;

(3) 材料：沪硅产业、立昂微、安集科技、鼎龙股份、彤程新材、华懋科技。

■ 静待周期复苏：

(1) 存储：兆易创新、北京君正、东芯股份、深科技、普冉股份；

(2) 模拟：圣邦股份、纳芯微、思瑞浦。

图表 17: 盈利预测与财务指标

代码	重点公司	现价	EPS				PE			评级
		2023/7/8	2022A	2023E	2024E	2022A	2023E	2024E		
603501.SH	韦尔股份	105	0.8	1.8	2.9	130	58	36	买入	
603986.SH	兆易创新	105	3.1	1.6	2.8	34	64	37	买入	
300327.SZ	中颖电子	29	0.9	0.8	1.0	31	36	28	买入	
688595.SH	芯海科技	34	0.0	0.6	1.6	1650	60	22	NA	
300661.SZ	圣邦股份	82	1.8	1.3	2.0	44	63	40	买入	
688173.SH	希荻微	22	0.0	0.2	0.3	-582	130	79	买入	
688536.SH	恩瑞浦	224	2.2	3.6	5.5	101	62	41	NA	
300782.SZ	卓胜微	107	2.0	2.4	3.5	53	45	31	NA	
600460.SH	士兰微	31	0.7	1.1	1.4	42	28	22	买入	
300373.SZ	扬杰科技	43	2.0	2.8	3.4	21	16	13	买入	
603290.SH	斯达半导	226	4.8	6.8	9.4	47	33	24	买入	
688711.SH	宏微科技	64	0.5	1.1	1.6	123	56	40	买入	
605358.SH	立昂微	37	1.0	2.1	2.5	37	18	15	买入	
300666.SZ	江丰电子	68	0.9	1.6	2.4	76	43	29	买入	
688126.SH	沪硅产业	21	0.1	0.1	0.2	170	170	131	买入	
002436.SZ	兴森科技	15	0.3	0.3	0.5	51	50	28	买入	
002409.SZ	雅克科技	73	1.1	1.8	2.5	64	40	30	NA	
300054.SZ	鼎龙股份	23	0.5	0.6	0.7	49	43	31	NA	
688019.SH	安集科技	157	3.1	3.9	5.3	52	41	30	NA	
688268.SH	华特气体	77	1.7	2.2	2.9	45	35	26	NA	
688106.SH	金宏气体	26	0.5	0.6	0.8	53	40	32	NA	
002371.SZ	北方华创	285	4.8	4.6	6.1	59	62	47	买入	
688037.SH	芯源微	157	1.5	2.1	2.9	108	76	54	买入	
688200.SH	华峰测控	144	3.9	4.7	5.9	37	31	25	买入	
688012.SH	中微公司	149	1.9	2.2	2.9	79	67	51	买入	
688630.SH	芯基微装	77	1.1	1.8	2.5	68	44	31	NA	
688981.SH	中芯国际	49	1.8	0.7	1.1	27	69	43	买入	
1347.HK	华虹半导体	26	0.2	0.2	0.2	130	146	133	NA	
600584.SH	长电科技	31	1.8	1.2	1.8	17	26	17	买入	
603005.SH	晶方科技	20	0.3	0.6	0.8	58	36	25	NA	
002156.SZ	通富微电	22	0.4	0.6	0.8	64	39	28	买入	
000021.SZ	深科技	20	0.4	0.6	0.7	47	32	27	NA	
002185.SZ	华天科技	9	0.2	0.3	0.4	39	36	25	NA	
688385.SH	复旦微电	56	1.4	1.8	2.4	41	31	24	买入	
688107.SH	安路科技	55	0.1	0.3	0.4	367	217	125	买入	
603893.SH	瑞芯微	73	0.7	2.5	3.3	102	29	22	买入	
688008.SH	澜起科技	64	1.1	1.0	1.9	56	61	33	NA	
688099.SH	晶晨股份	85	1.8	2.8	3.2	48	30	27	NA	

来源: wind, 中泰证券研究所

注: 已覆盖公司采用我们预测值, 未覆盖公司采用 wind 一致预期。

## 六、风险提示

- 需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。



**投资评级说明：**

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。

**重要声明：**

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。事先未经本公司书面授权，任何机构和个人，不得对本报告进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。